

证券代码：688120

证券简称：华海清科

公告编号：2025-079

## 华海清科股份有限公司

### 关于 CMP 装备累计出机超 800 台的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示

●近日，华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）化学机械抛光（CMP）装备出机累计超 800 台，涵盖公司 Universal-H300、Universal-S300 等多款主力机型和最新款机型，不仅全面覆盖逻辑、3D NAND 存储、DRAM 存储等主流产品线，更成功切入大硅片、第三代半导体、CIS、MEMS、MicroLED 以及先进封装等领域头部客户供应链，已实现国内主流集成电路制造产线的全覆盖和批量化应用。

●公司 CMP 装备出机前已通过出厂检测，但机台仍需在客户现场完成安装调试及工艺验证，可能受客户产线适配、技术参数优化等因素影响，存在验证周期延长或不及预期的风险，公司将全力配合客户推进验收工作。同时，公司新产品机台尚需市场推广和更多客户验证，存在未来市场推广与客户开拓不及预期的风险。

#### 一、本次出机情况及对公司影响

近日，公司 CMP 装备累计出机超 800 台，涵盖公司 Universal-H300、Universal-S300 等多款主力机型和最新款机型，不仅全面覆盖逻辑、3D NAND 存储、DRAM 存储等主流产品线，更成功切入大硅片、第三代半导体、CIS、MEMS、MicroLED 以及先进封装等领域头部客户供应链，已实现国内主流集成电路制造产线的全覆盖和批量化应用，标志着公司技术先进性、产品成熟度、质量可靠性与市场适配性获得行业高度认可，彰显国产 CMP 装备在核心应用领域的替代能力

持续增强，公司产品市场认可度与行业影响力稳步提升，进一步夯实了公司在 CMP 装备领域的国产龙头地位。

当前国内 AI 技术在算法架构、算力密度等核心维度持续突破，带动先进封装与芯片堆叠技术迎来深层发展机遇。公司 CMP 装备可与公司减薄装备、划切装备、边抛装备等产品形成协同效应，为先进封装与芯片堆叠等领域提供切、磨、抛的成套解决方案，未来产品应用场景将持续拓宽，市场增长空间进一步打开。同时，随着公司 CMP 装备保有量的不断攀升，公司“装备+服务”平台化战略协同效应显著释放，关键耗材与维保服务业务量也将快速提升，为公司贡献持续稳定的利润增长点。

未来，公司将继续坚持核心技术自主创新，持续加大研发投入力度，一方面聚焦先进制程突破，围绕现有产品体系，针对更先进制程工艺及功能需求推进技术迭代升级，不断提升产品核心性能；另一方面结合自身业务发展布局，密切跟踪 HBM、CoWoS 等先进封装技术演进趋势，持续推进产品技术革新与品类拓展，致力于为客户提供更先进、多元的成套解决方案，充分把握集成电路产业链技术升级与国产替代机遇，进一步强化核心竞争力、提升市场份额。

## 二、相关风险提示

公司 CMP 装备出机前已通过出厂检测，但机台仍需在客户现场完成安装调试及工艺验证，可能受客户产线适配、技术参数优化等因素影响，存在验证周期延长或不及预期的风险，公司将全力配合客户推进验收工作。同时，公司新产品机台尚需市场推广和更多客户验证，存在未来市场推广与客户开拓不及预期的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

华海清科股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 20 日